

2025年3月期 (第23期) 決算説明会

2025年5月14日

株式会社ジーダット



1. 2025年3月期 決算概要

2. 2026年3月期 計画・業績予想

2025年3月期のポイント

売上高：20.6億円（対前年比0.1%増）
営業利益：2.5億円（同14.9%減）
経常利益：2.9億円（同22.4%減）

半導体市場低調の中、前年並の売上を確保

固定費増（人材への投資）により営業利益減

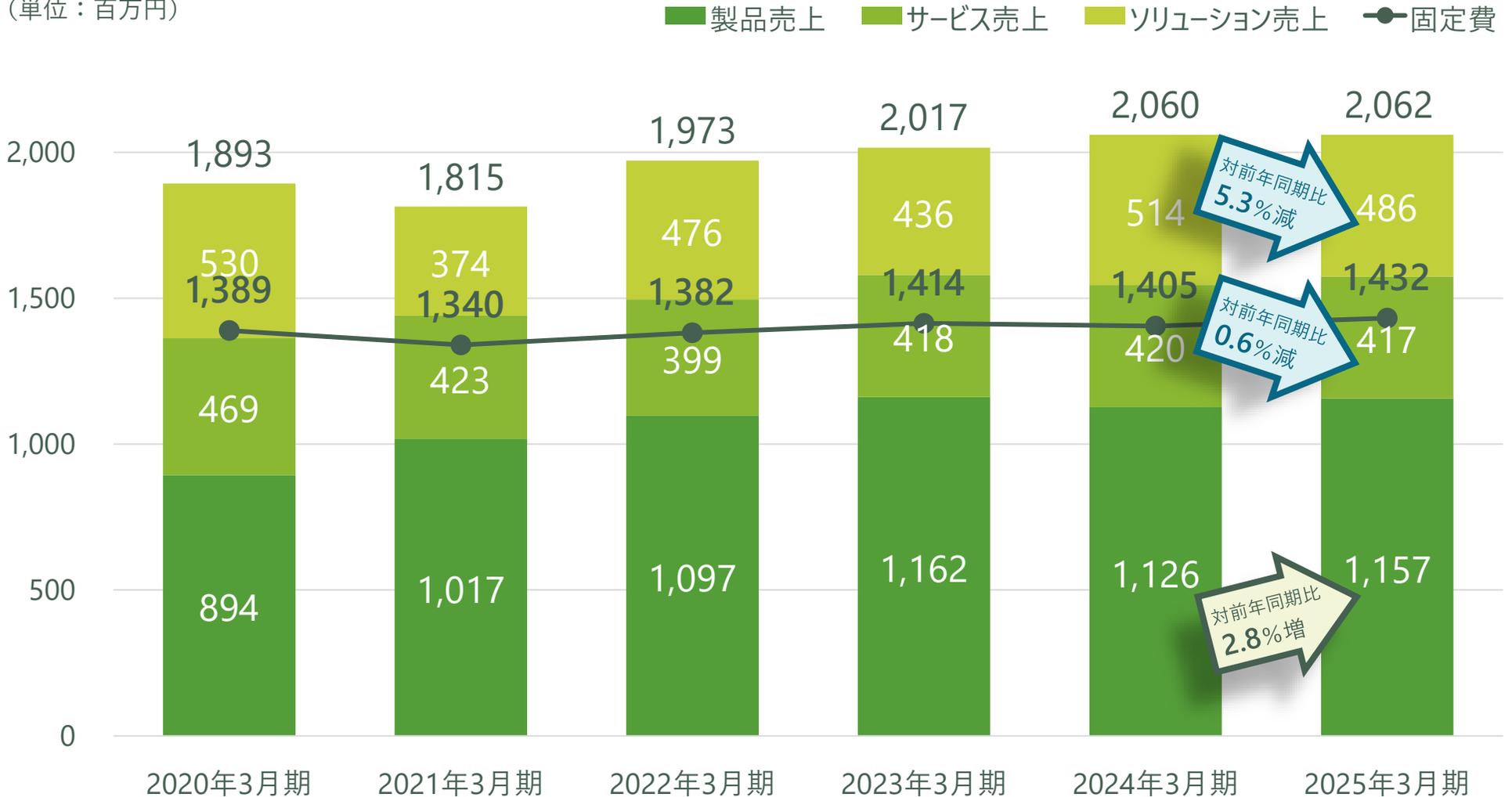
助成金減、為替差損等により経常利益減

2025年3月期業績概要

(単位：百万円)	2024年3月期		2025年3月期		
	実績	売上高比	実績	売上高比	対前期比
売上高	2,060	100.0%	2,062	100.0%	+0.1%
売上総利益	1,288	62.5%	1,305	63.3%	+1.4%
販売費及び 一般管理費	985	47.8%	1,048	50.8%	+6.4%
営業利益	302	14.7%	256	12.5%	△ 14.9%
経常利益	374	18.1%	290	14.1%	△ 22.4%
当期純利益	328	15.9%	213	10.3%	△ 35.1%

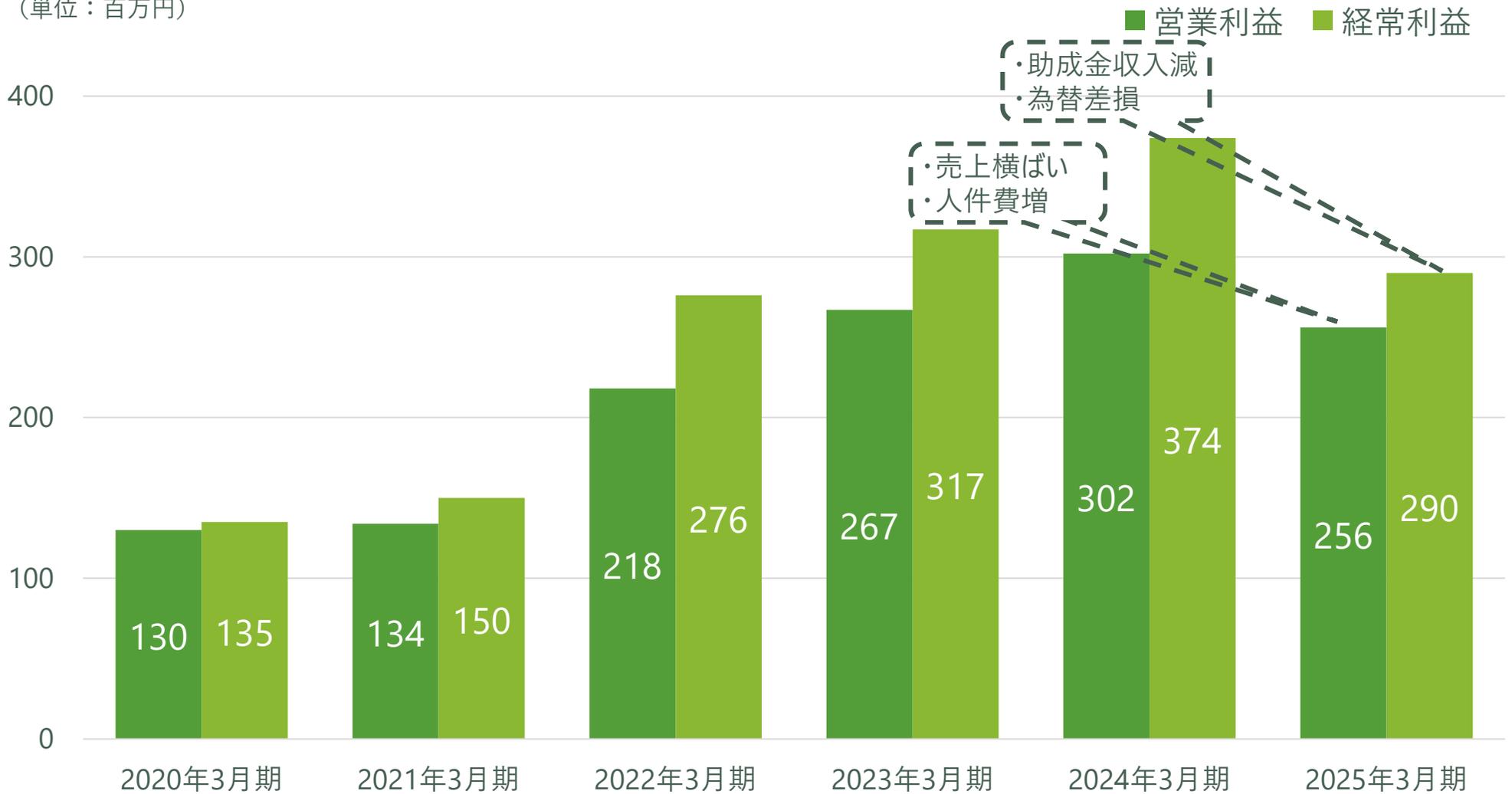
売上高・固定費の推移

(単位：百万円)



利益の推移

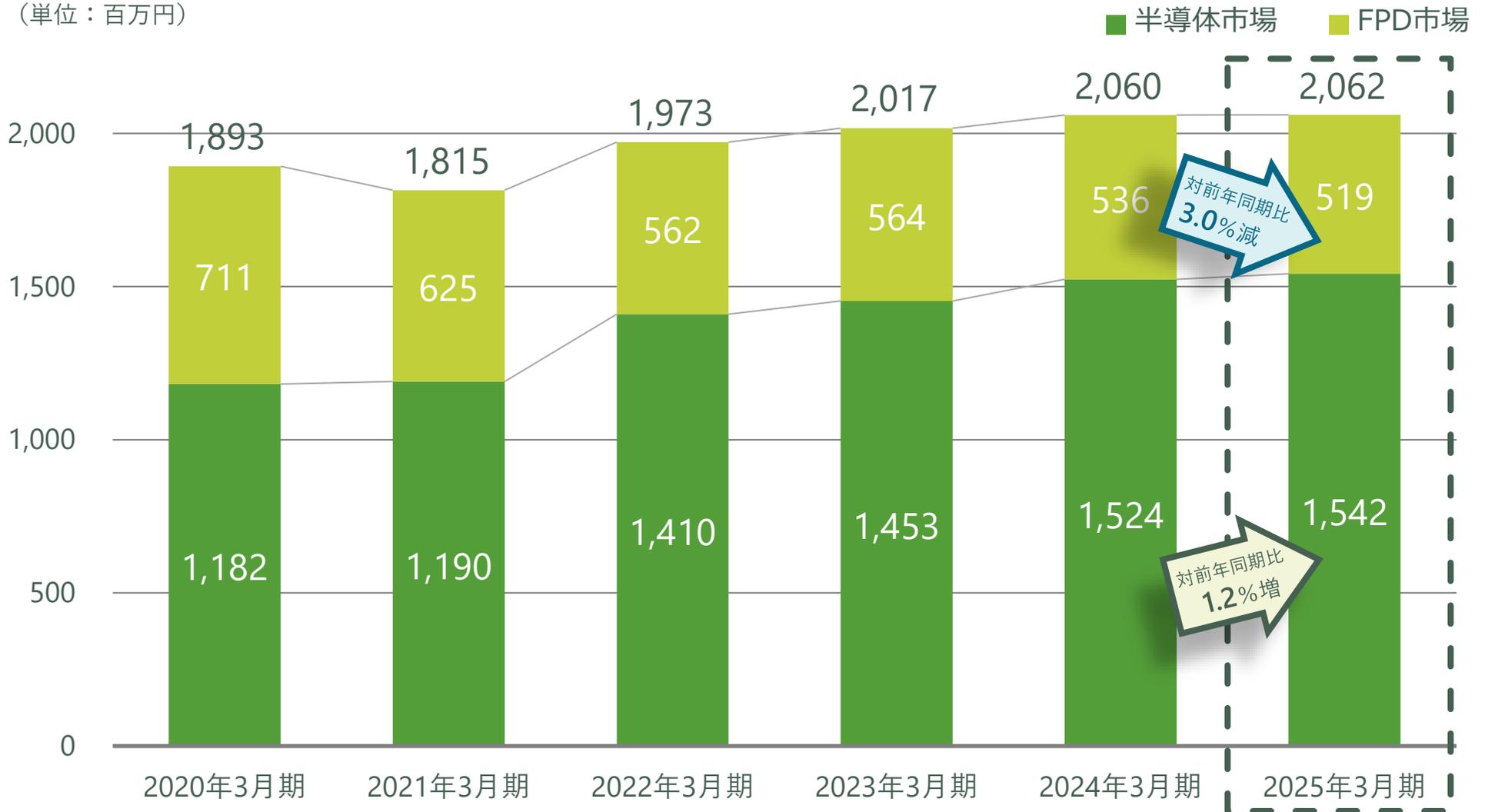
(単位：百万円)



※ FPD : Flat Panel Display etc.

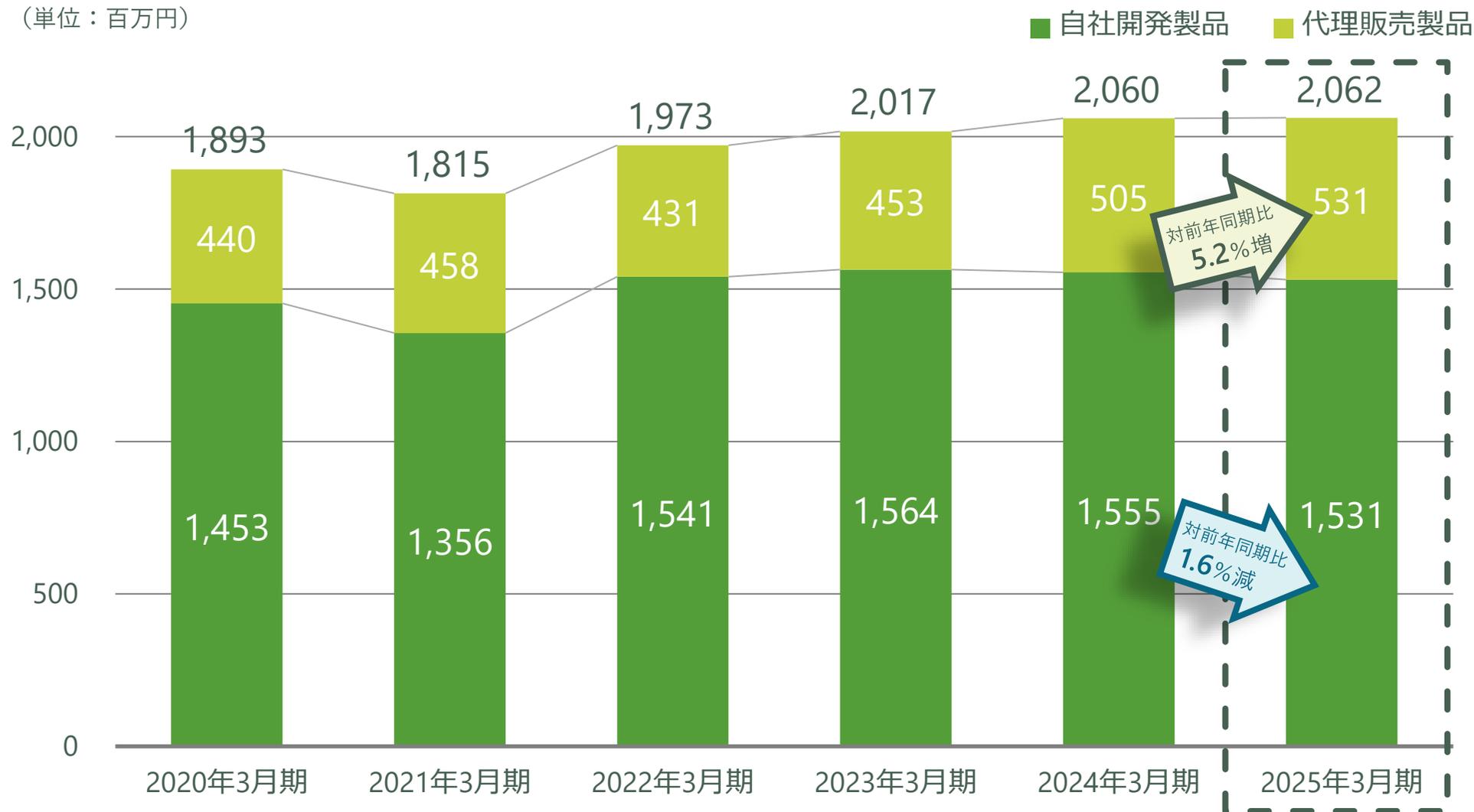
市場別売上高（半導体/FPD※）

（単位：百万円）



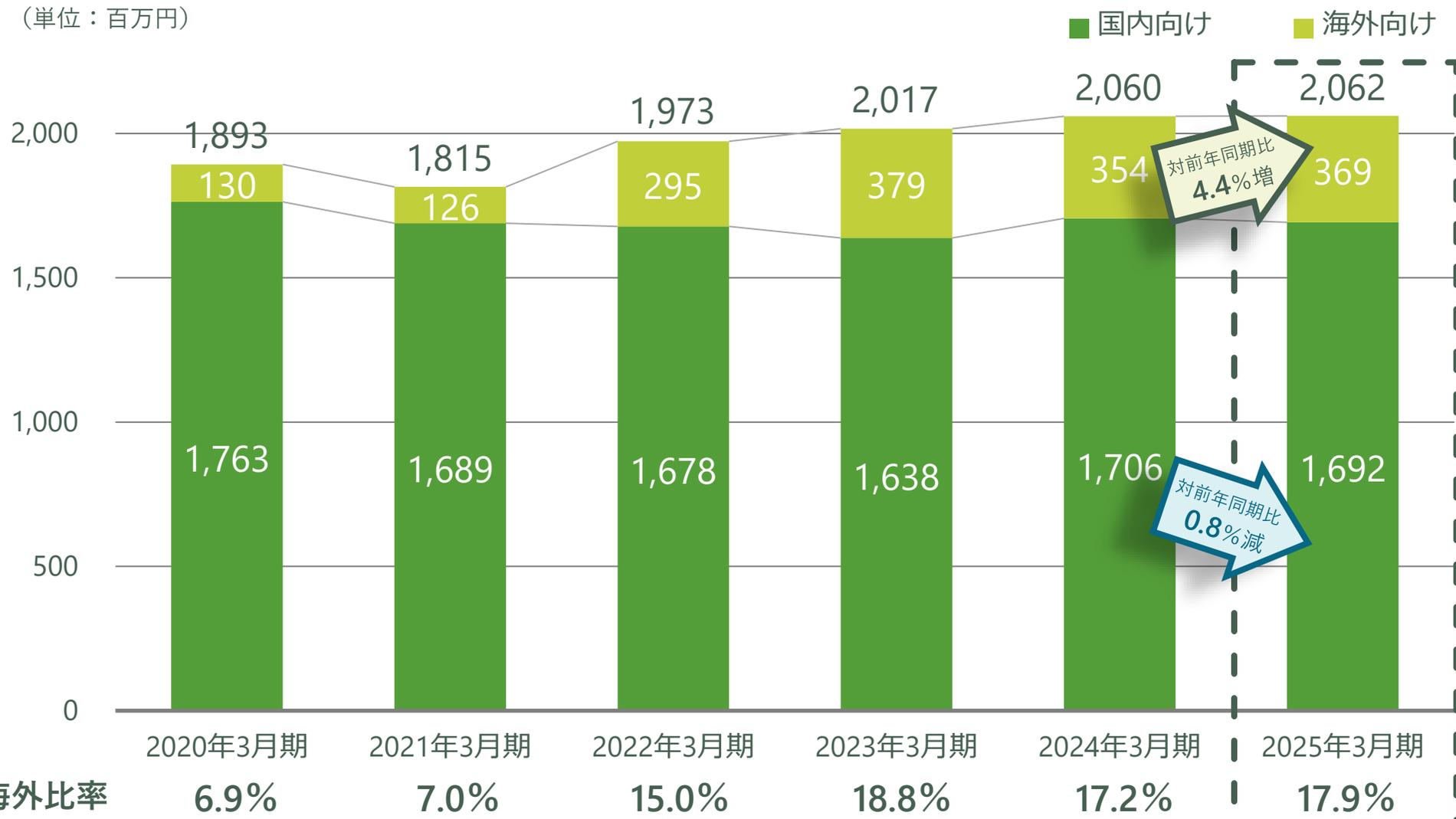
製品区分別売上高（自社開発/代理販売）

（単位：百万円）



販売先別売上高（国内/海外）

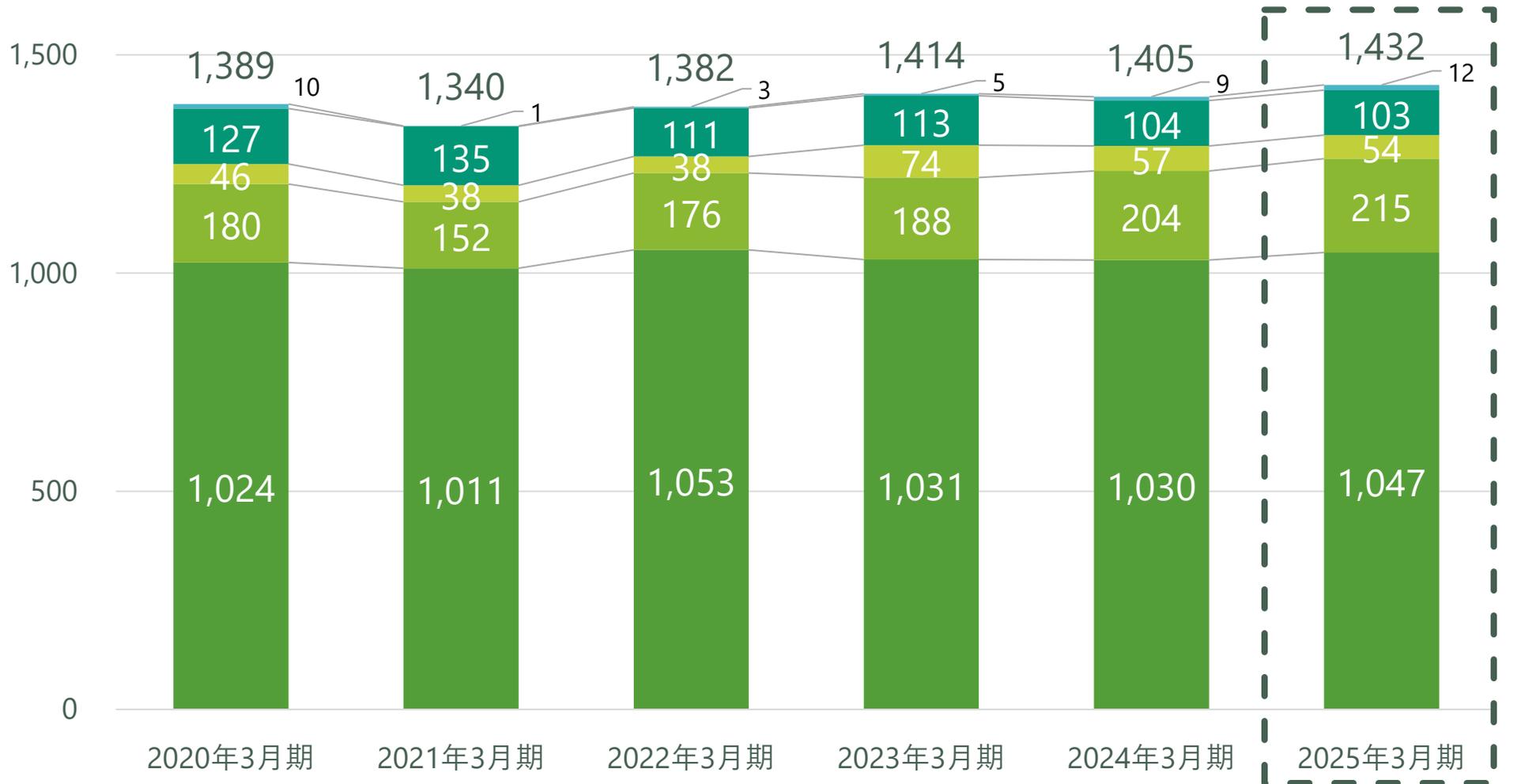
（単位：百万円）



固定費内訳

(単位：百万円)

■ 人件費 ■ その他 ■ 外注費 ■ 建物関係・減価償却費 ■ 販売促進・広告宣伝費



貸借対照表 — 前期末比 —

(単位：百万円)	2024年 3月末	2025年 3月末	差異		2024年 3月末	2025年 3月末	差異
(資産の部)					(負債の部)		
I 流動資産	4,198	3,107	△ 1,090	I 流動負債	977	675	△ 302
1 現金及び預金	3,485	2,545	△ 939	1 買掛金	63	56	△ 6
2 電子記録債権	235	219	△ 16	2 未払金	46	21	△ 24
3 売掛金	418	286	△ 132	3 未払費用	48	38	△ 9
4 仕掛品	2	2	△ 0	4 未払法人税等	49	12	△ 36
5 原材料	4	0	△ 3	5 前受金	637	441	△ 195
6 前渡金	9	23	14	6 預り金	17	9	△ 8
7 前払費用	37	25	△ 11	7 賞与引当金	106	94	△ 12
8 その他	4	4	0	8 その他	9	—	△ 9
II 固定資産	317	1,165	847	II 固定負債	3	3	—
1 有形固定資産	22	22	0	資産除去債務	3	3	—
2 無形固定資産	18	14	△ 3	負債合計	981	679	△ 302
3 投資その他の資産	277	1,128	851	(純資産の部)			
(1)投資有価証券	138	132	△ 6	I 株主資本	3,534	3,594	59
(2)長期前払費用	0	2	1	1 資本金	762	762	—
(3)繰延税金資産	99	56	△ 42	2 資本剰余金	893	893	—
(4)長期預金	—	900	900	3 利益剰余金	1,907	1,966	59
(5)その他	38	37	△ 1	4 自己株式	△ 28	△ 28	—
資産合計	4,516	4,273	△ 242	純資産合計	3,534	3,594	59
				負債純資産合計	4,516	4,273	△ 242

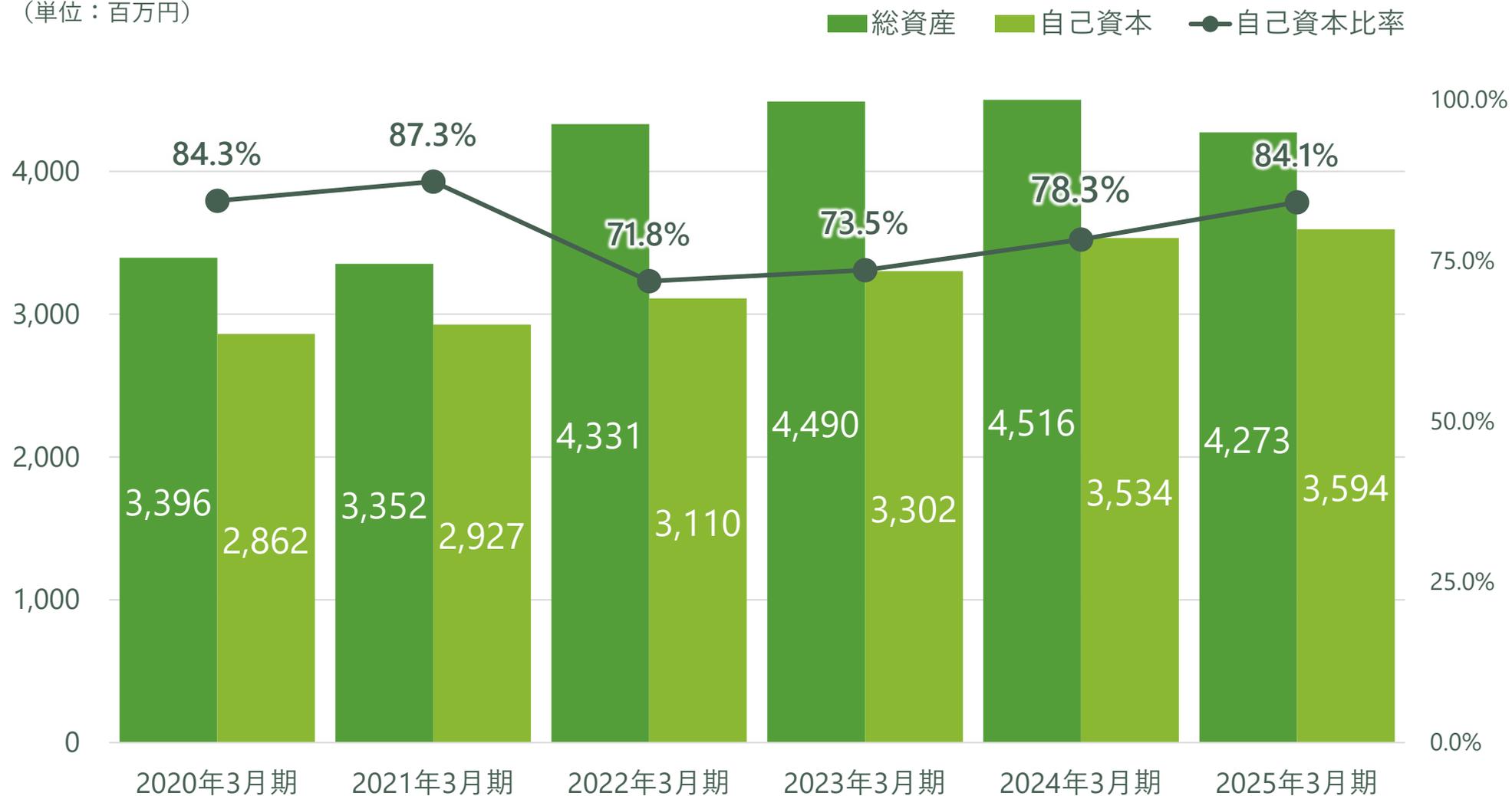
キャッシュフロー計算書 — 前年同期比 —

(単位：百万円)

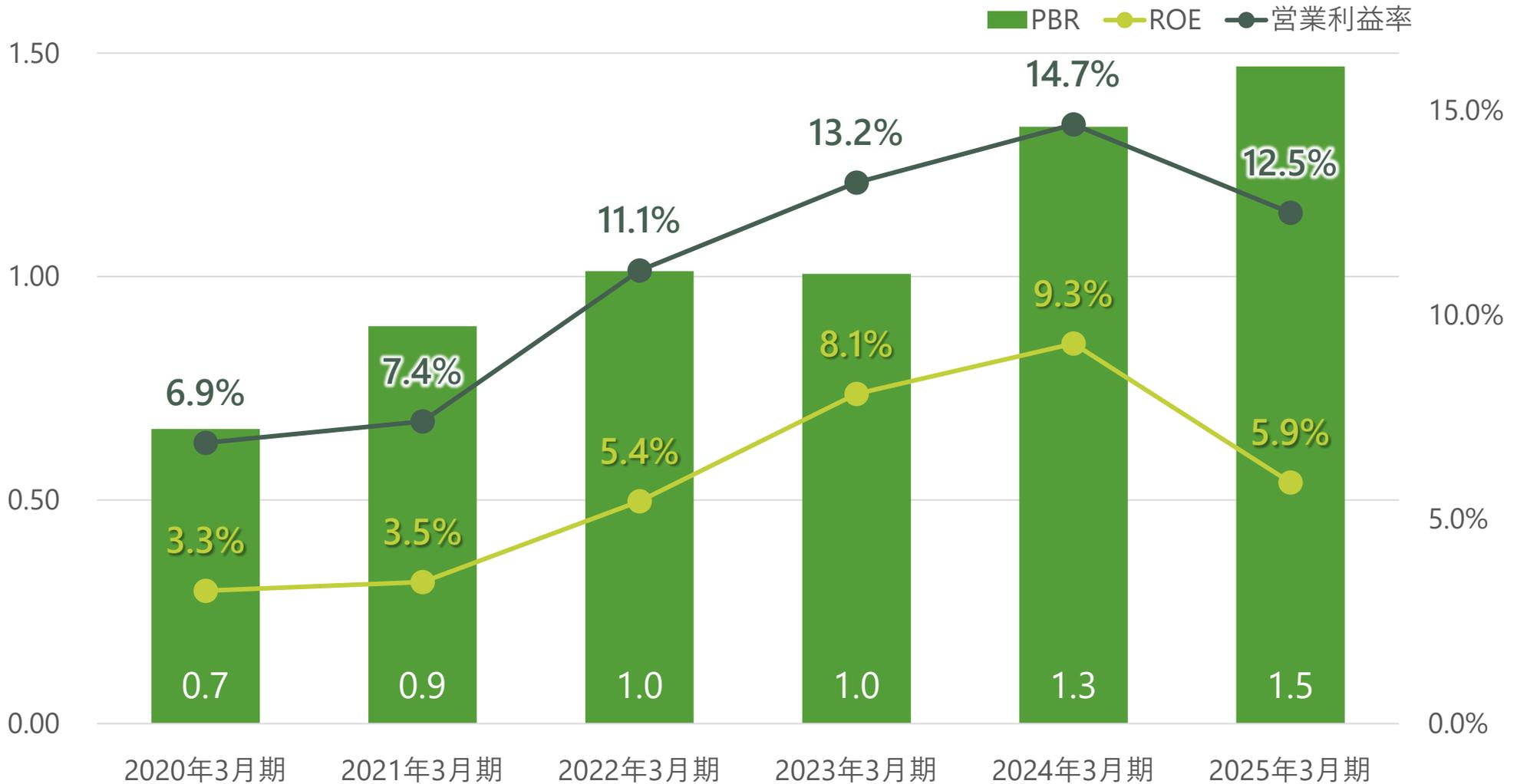
	2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 65	137	203
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3	13	17
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96	△ 153	△ 57
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1	0	△ 1
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	△ 163	△ 1	161
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,710	2,547	△ 163
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	2,547	2,545	△ 1

総資産・自己資本

(単位：百万円)



經營指標



トピックス

■ 主力製品の機能拡張を継続

■ SX-Meister Ver.18.0リリース

- AIを活用した新製品「SX-Meister SCAI」のリリース
- アナログLSI設計自動化に向けた機能拡張
- パワー半導体設計向けツールの機能強化

■ TSMCのOIP* EDA Allianceに加入・出展 *Open Innovation Platform

- TSMCの最先端プログラム技術でお客様のイノベーションを加速
- TSMCの「OIP Ecosystem Forum」に出展、当社技術を紹介

■ 国内販売代理店契約を新たに締結

- 仏XYALIS社・POLLEN社の競争力のある製品販売が可能に

1. 2025年3月期 決算概要

2. 2026年3月期 計画・業績予想

2026年3月期のポイント

売上高：22億円（対前年比6.7%増）

営業利益：2.9億円（同12.8%増）

経常利益：3.0億円（同3.4%増）

コア製品の競争力・販売力の強化
（開発強化と顧客開拓）

代理販売製品の拡大
（取り扱い製品のラインナップ拡張）

デバイスソリューションの売上拡大
（新規顧客開拓）

2026年3月期業績概要

(単位：百万円)	2025年3月期		2026年3月期		
	実績	売上高比	計画	売上高比	対前期比
売上高	2,062	100.0%	2,200	100.0%	+6.7%
売上総利益	1,305	63.3%	1,360	61.8%	+4.2%
販売費及び 一般管理費	1,048	50.8%	1,070	48.6%	+2.0%
営業利益	256	12.5%	290	13.2%	+12.8%
経常利益	290	14.1%	300	13.6%	+3.4%
当期純利益	213	10.3%	220	10.0%	+3.1%

電子デバイス業界の状況

■ 半導体関連

- AI関連デバイスへの高い期待
- パワー半導体のEV化は減速、再エネ・民生品等の需要は好調
- スマートフォン・パソコン等向けのオンデバイスの需要は低調

■ FPD(Flat Panel Display etc.)関連

- コモディティ化によりFPD設計ツール需要は縮小傾向

■ 地政学的関連

- アメリカトランプ政権の関税政策による景気後退感の高まり
- 中国市場の低迷は続く

課題と施策（1）

■ コア製品の競争力・販売力を強化

■ 重点テーマに向けた開発を継続

- アナログLSI設計自動化環境(ACC)の拡張
- パワーデバイス向け設計効率化機能の拡張
- AIを用いたアナログ合成ツールの製品化

■ 研究開発活動の強化

- デバイス設計部門との連携強化 ⇒ 設計者目線の製品づくり
- 外部技術の導入・活用を促進

■ 販売促進活動の強化

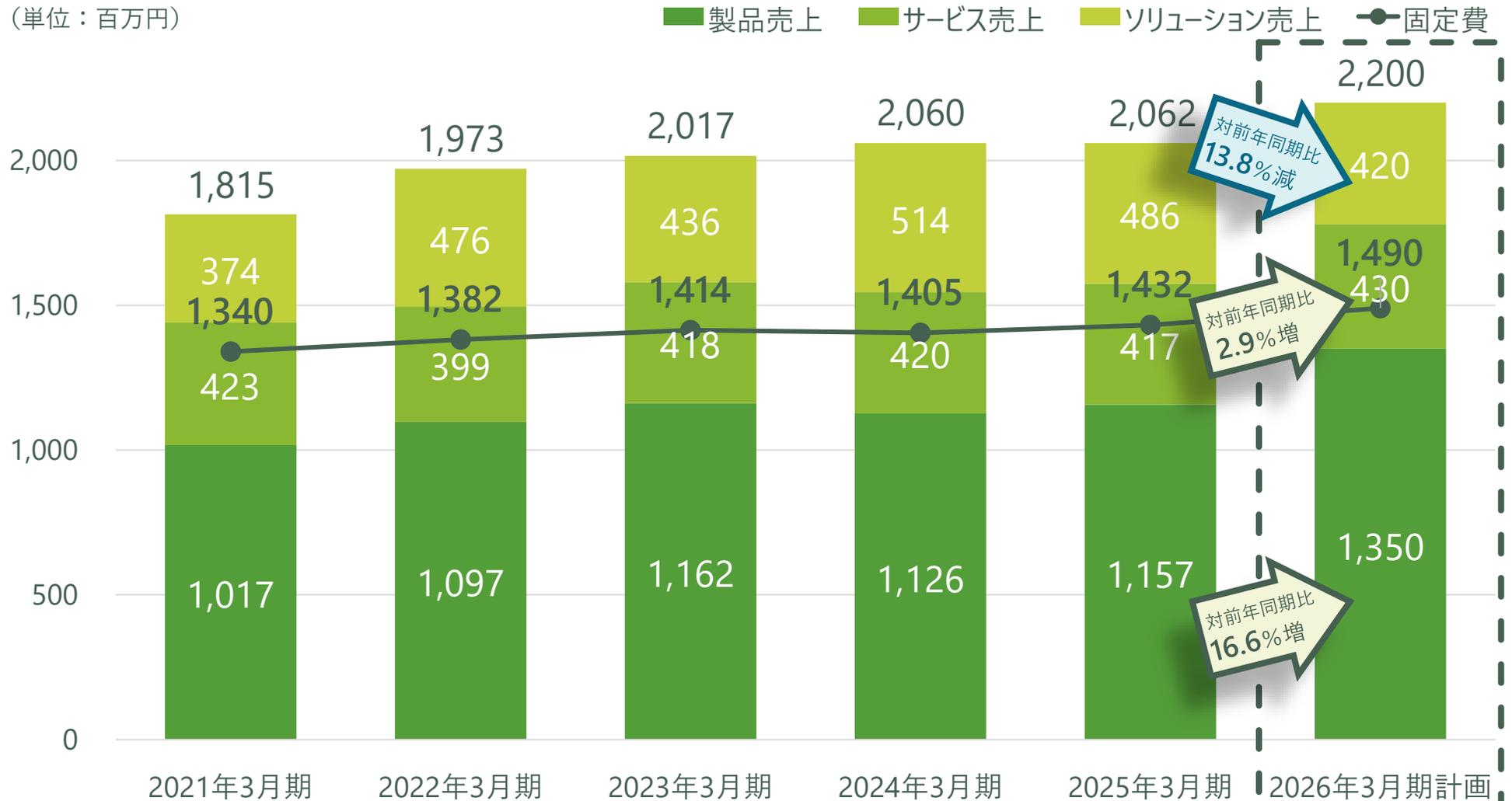
- 新規リリース製品の販促、情報発信活動の促進
- 大学、高専、企業との連携を強化

課題と施策（2）

- 海外半導体市場向け売上の拡大
 - 大規模フォトマスクデータブラウザ：HOTSCOPEの販促強化
 - 「プラットフォーム」戦略の促進
- カスタムソフトウェアビジネスの拡張
 - デバイス製造装置メーカーとの連携
 - 半導体後工程分野への進出
- デバイス設計受託サービスの拡大
 - 受託可能な設計量の拡張
 - 国内・海外新規顧客の開拓と拡張
 - SX-Meisterを駆使した設計 & コンサル型提案の実現

売上高・固定費の推移

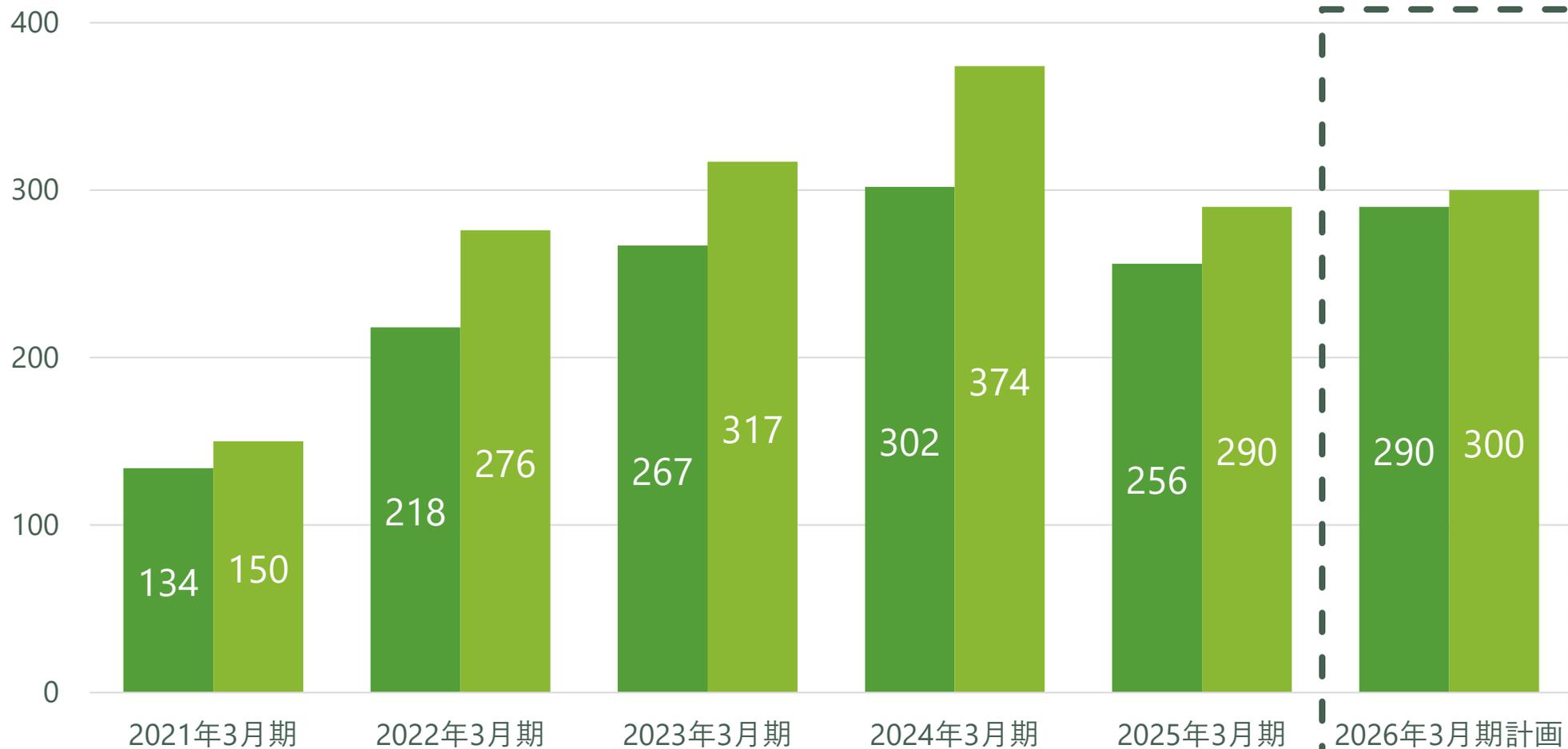
(単位：百万円)



利益の推移

(単位：百万円)

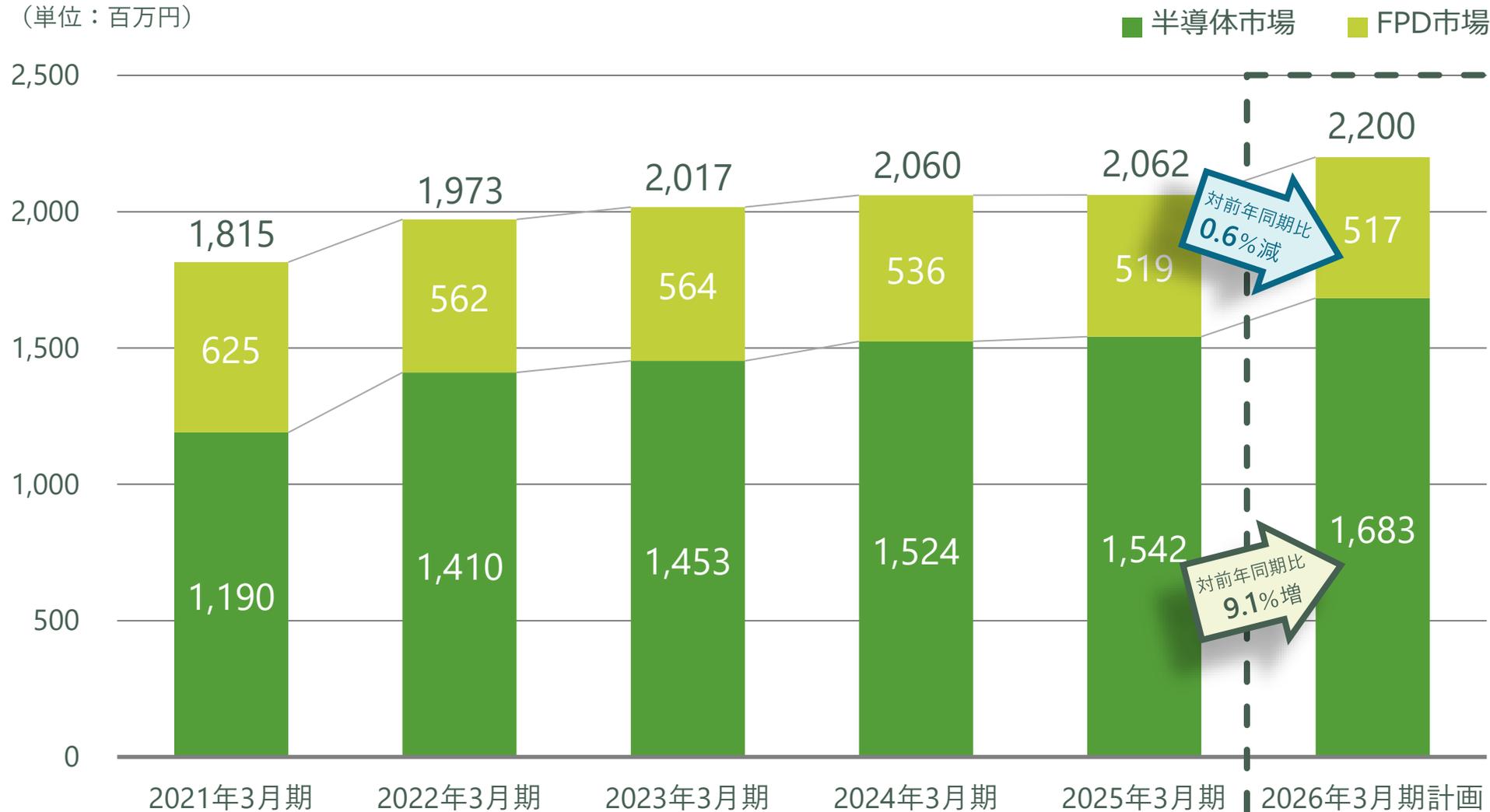
■ 営業利益 ■ 経常利益



※ FPD : Flat Panel Display etc.

市場別売上高（半導体/FPD※）

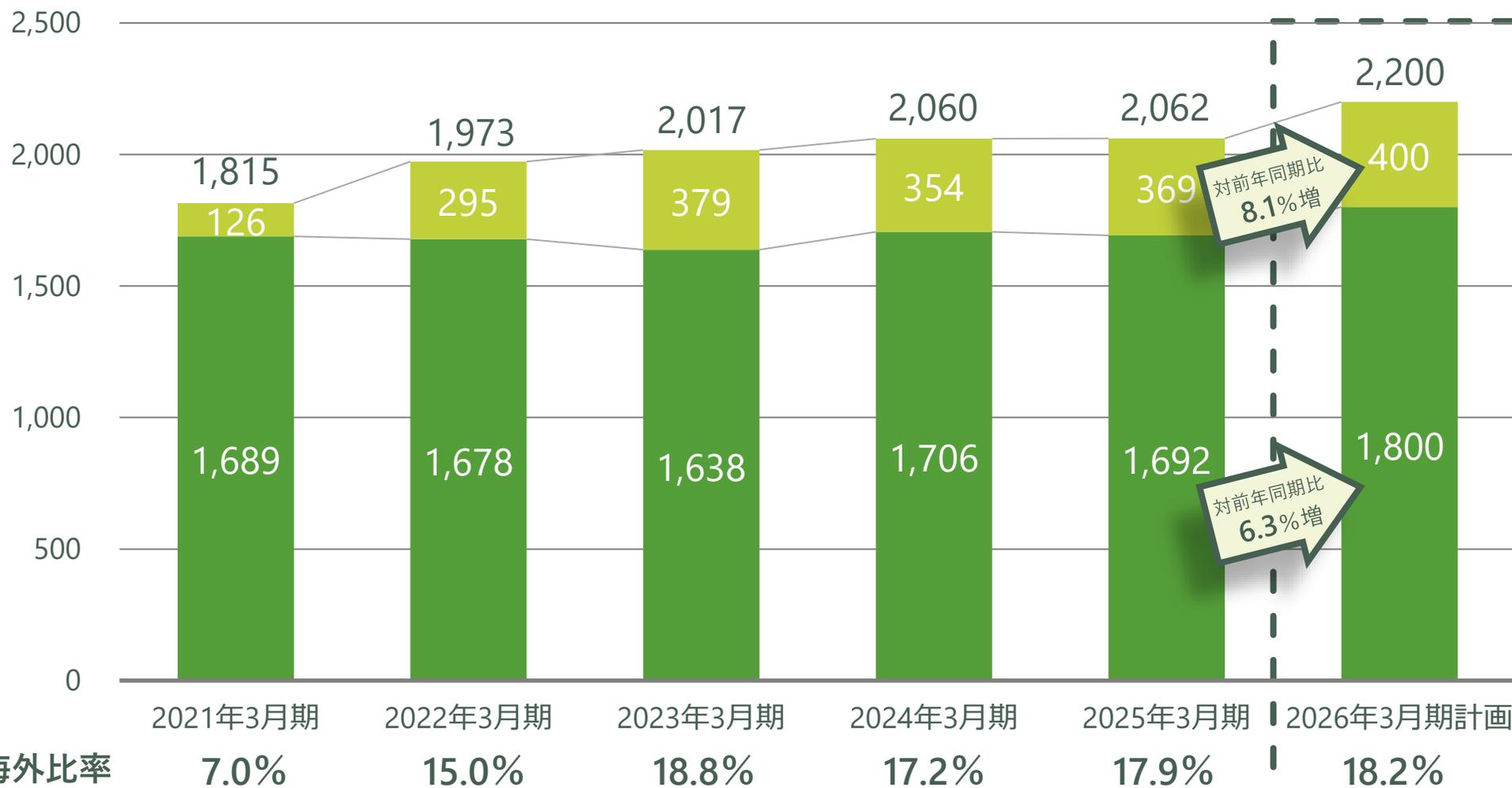
（単位：百万円）



販売先別売上高（国内/海外）

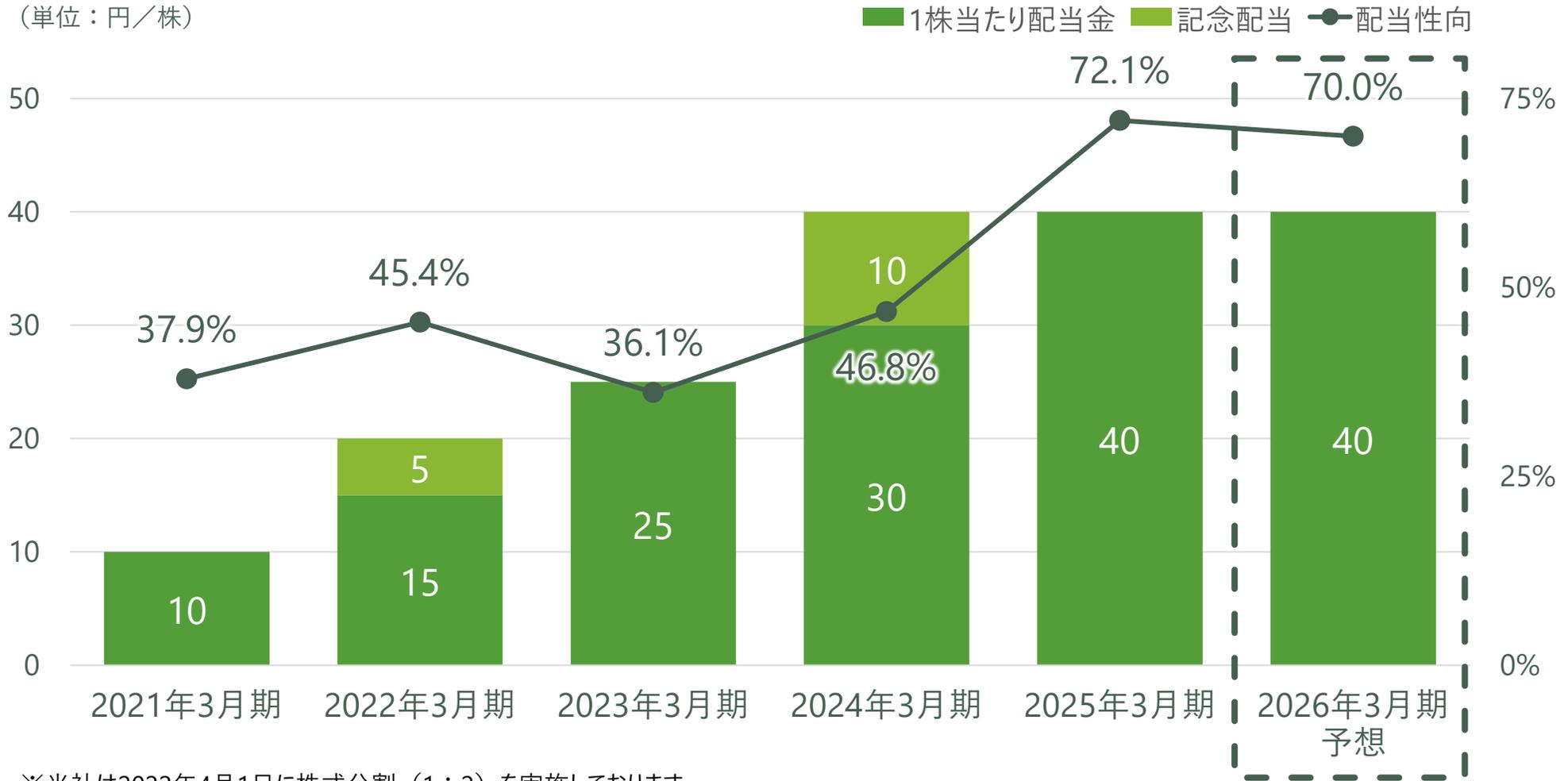
（単位：百万円）

■ 国内向け ■ 海外向け



株主還元：配当金の水準を維持

(単位：円/株)



※当社は2022年4月1日に株式分割（1：2）を実施しております。
2022年3月期以前の1株当たり配当金は、比較のために株式分割後の数値で記載しております。

ご清聴ありがとうございました